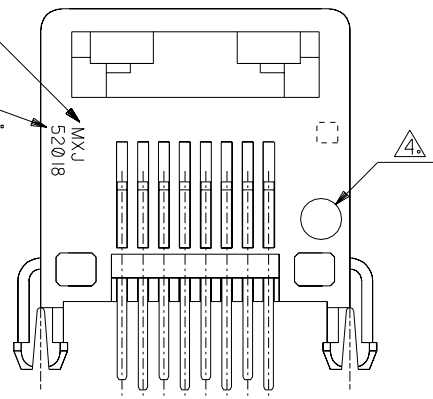
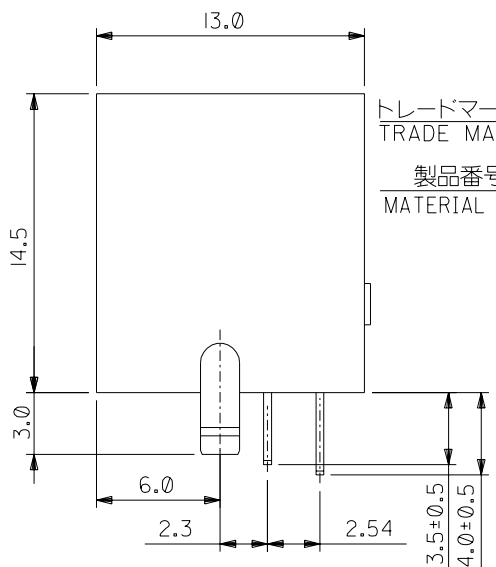
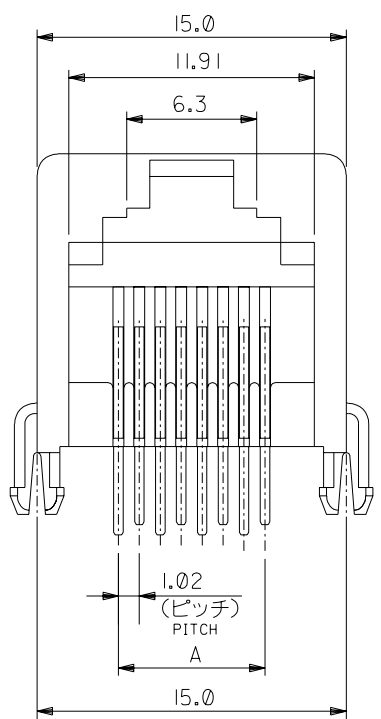


:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

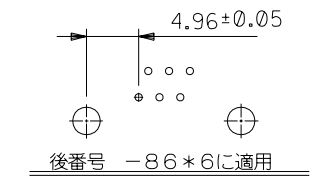
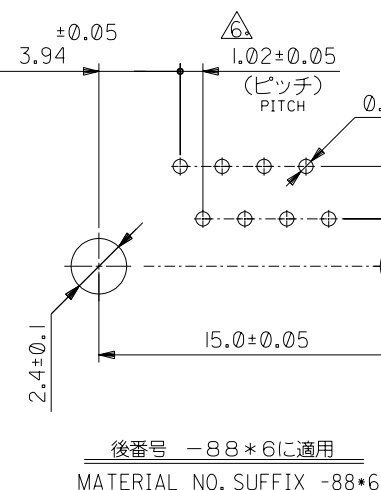
ENG. NO. SD-52018-001

EDP NO. #

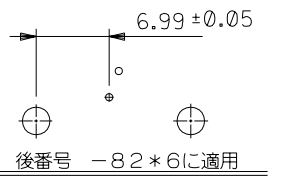


注) NOTES

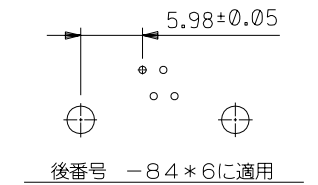
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG. : POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM. : PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA : TIN 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE : NICKEL 1.0µmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW : 0.1µmMIN. GREEN : 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE : 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- 公差非累積。
NON-ACCUMULATIVE
- 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.



後番号 -86*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -86*6



後番号 -82*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -82*6



後番号 -84*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -84*6

後番号 -88*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -88*6

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	+0.3
10以上 OVER 30未満 UNDER	+0.25
10未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

52018-8**6 MODEL NO.	ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 MATERIAL No.
8	7.11			1.27	52018-8846
				0.76	-8836
				0.38	-8826
				0.1	-8816
				1.27	-8646
6	5.08			1.27	-8646
4	3.05			1.27	-8446
2	1.02			1.27	52018-8246

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	MOLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	EDP. NO. #
適用電線範囲 WIRE RANGE	#	ENG. NO. SD-52018-001
被覆外径 INS. RANGE	#	REV 0
DATE	DATE	TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-
DR. M.NABEI	CHK'D BY M.NABEI	
DR. M.SASAO	CHK'D BY M.SASAO	
DATE	DATE	SCALE 4-1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

SD-52018-001.501

MXJ-8